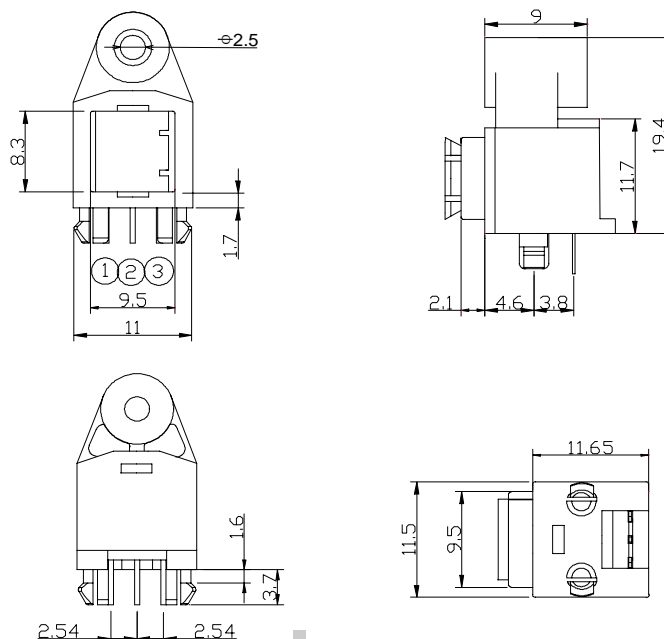


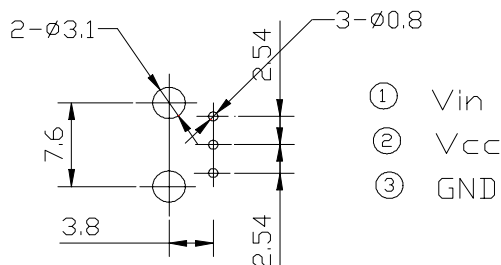
特性

- 1.使用塑胶光纤作单向资料传输，符合EIAJ CP-1201 标准(对于音频接口包括光纤内部连接)
- 2.资料传送速率:  
最大 13.2Mbps (NRZ 信号)
- 3.操作电压 :2.7 - 5.5 V
- 4.TTL 及高速 C-MOS 逻辑 IC 匹配
- 5.抗静电能力: IC≥5KV

外观尺寸



建议钻孔方式（由焊锡面观看）



备注:

1. 以上尺寸单位均为mm。
2. 公差: 0<L≤5 ±0.1mm, 5<L≤10 ±0.2mm,L>10±0.3mm 特别标示的除外。

最大等级

@TA=25°C

参数	符号	等级	单位
供应电压	V <sub>cc</sub>	-0.5 to + 7.0	V
输入电压	V <sub>in</sub>	-0.5 to V <sub>cc</sub> +0.5	V
操作温度	T <sub>opr</sub>	-20 to +70	°C
储存温度	T <sub>stg</sub>	-30 to +80	°C
焊锡温度 <sup>*1</sup>	T <sub>sol</sub>	260	°C

\*1 1次 5秒(≤2次)

## 建议操作条件

参数	符号	最小值	标准值	最大值	单位
操作电压	$V_{cc}$	2.7	---	5.5	V
传输速率 (NRZ信号)	T	---	---	13.2	Mbps

## 光电特性

(Ta=25°C, Vcc=5V, C<sub>L</sub>=15pf)

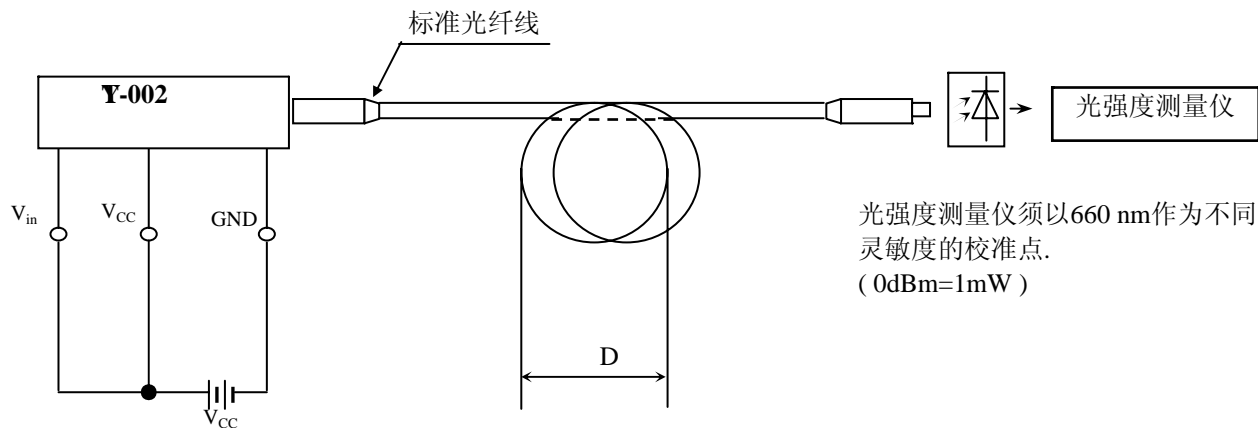
序号	参数	符号	条件	最小值	标准值	最大值	单位
1	发光波长	$\lambda_p$		---	660	---	nm
2	光纤耦合输出强度	$P_c$	参阅图. 1	-21	-18	-15	dBm
3	消耗电流	$I_{cc}$	参阅图. 2	2.5	---	7	mA
4	高准位输入电压	$V_{iH}$	参阅图. 2	2.0	---	$V_{cc}$	V
5	低准位输入电压	$V_{iL}$	参阅图. 2	---	---	0.8	V
6	低 → 高脉冲延迟时间	$t_{pLH}$	参阅图. 3	---	---	100	ns
7	高 → 低脉冲延迟时间	$t_{pHL}$	参阅图. 3	---	---	100	ns
8	脉冲宽度失真	$\Delta_{tw}$	参阅图. 3	-15	---	+15	ns
9	颤动 (jitter)	$\Delta_j$	参阅图. 3	---	1	15	ns

## 机械特性

参数	符号	条件	最小值	标准值	最大值	单位
插拔力	Fp	* 1	3.9	-	40	N

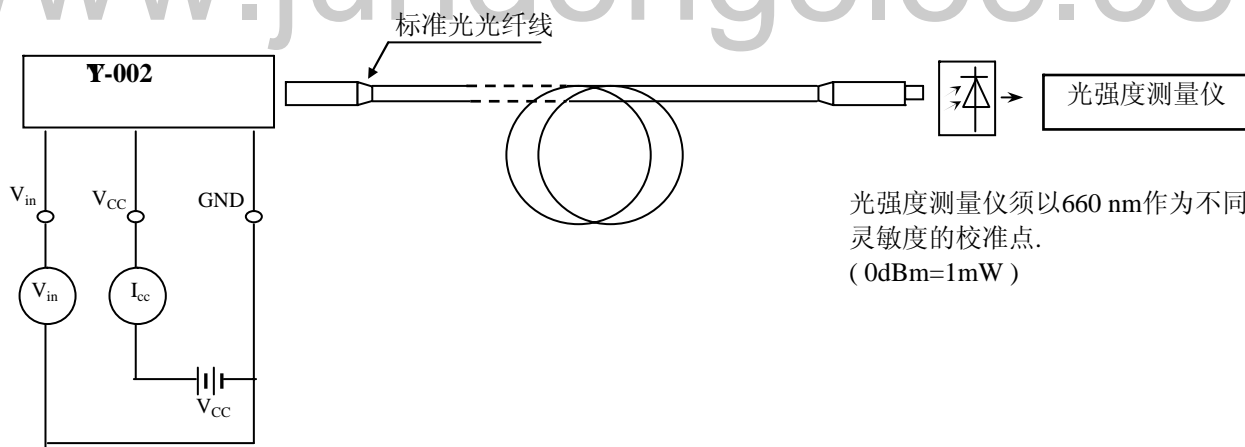
\* 1: 使用标准的光纤线 (980/1000 $\mu$ m)

图.1 光纤耦合输出光强度量测方法



备注: (1)Vcc=5.0V  
(2)标准光纤线束起时的直径需D>10cm

图.2 输入电压及消耗电流量测方法

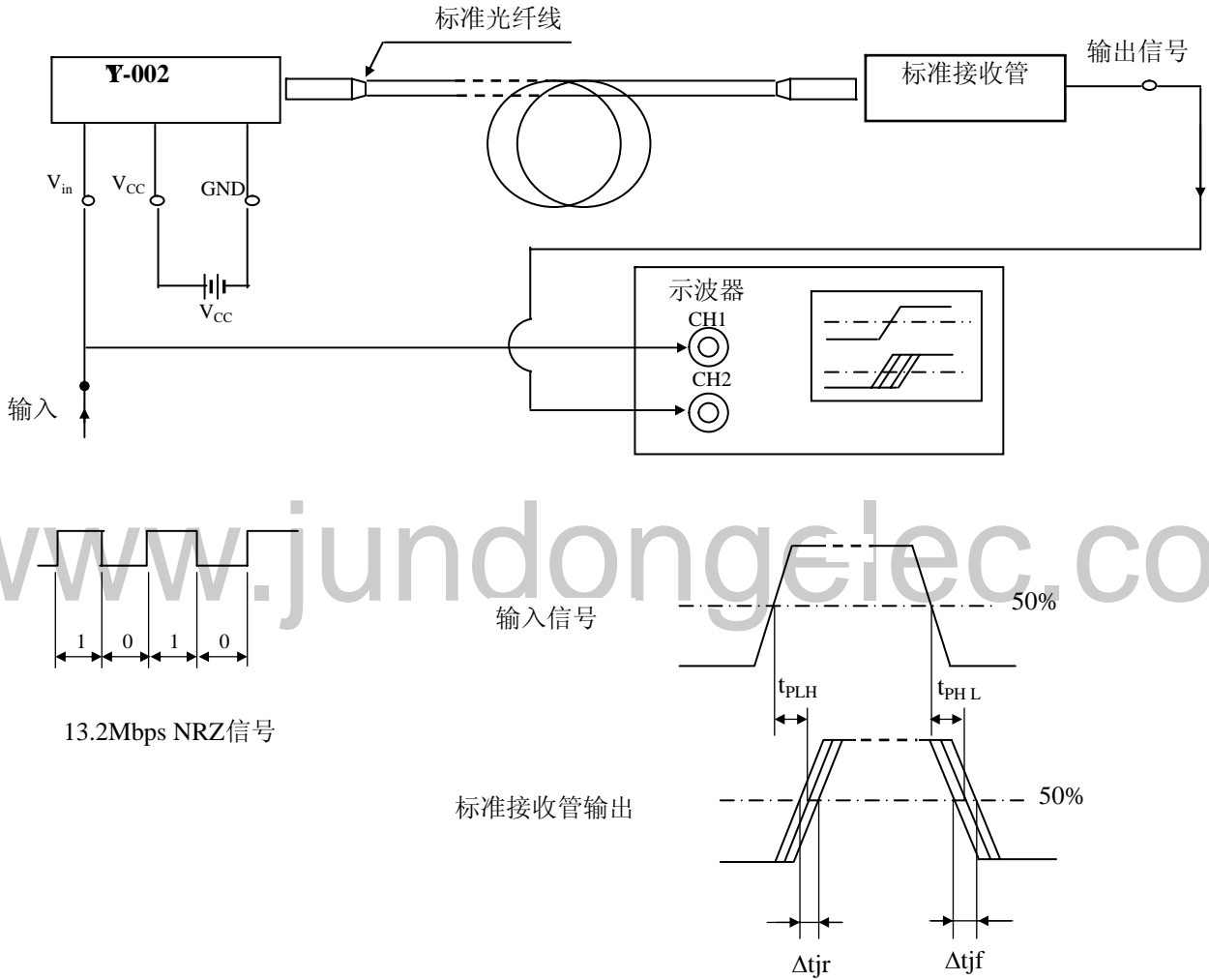


输入条件及判断方法

条件	判断方法
Vin=2.0V 或 以上	-21dBm<=Pc<=-15dBm, Icc=7mA 或以下
Vin=0.8V 或 以下	Pc <=-36dBm, Icc=7mA或以下

备注: Vcc=5.0V

图.3脉冲响应量测方法



测试项目

测试项目	标志	测试条件
低→高脉冲延迟时间	$t_{PLH}$	参阅上面方法
高→低脉冲延迟时间	$t_{PHL}$	参阅上面方法
波形宽度失真	$\Delta\tau\omega$	$\Delta\tau\omega = t_{PHL} - t_{PLH}$
低→高 颤动	$\Delta t_{jr}$	参阅上面方法
高→低 颤动	$\Delta t_{jf}$	参阅上面方法

备注: (1) 波形不允许因亮度增加造成过多的失真。

(2)  $V_{CC}=5.0\text{ V}$

(3) 示波器的探针电阻值需大于1M 电容值需小于10pF。

## 可靠性测试

NO.	测试项目	测试条件	判定标准	测试数量(n)	
				失效数量(c)	
1	老化试验	Vcc=5V, 500小时	满足光电特性中的No. 2~9项	n=10, c=0	
2	高温高湿储存	温度: 80°C ± 5°C 湿度: 85%RH 48小时		n=10, c=0	
3	低温储存	温度: -30°C ± 5°C , 48小时		n=10, c=0	
4	高低温循环	温度: -35°C ~ +85°C (85%RH) (30min) (30min) 20个循环		n=10, c=0	
5	跌落试验	将成品焊在PCB板上从1米高处让其自由跌落, 3个循环		n=10, c=0	
6	焊锡强度试验	将芯片焊在PCB板上, 用1kg重的物品倒挂在芯片引脚上, 1分钟		n=10, c=0	
7	高低温冲击试验	-35°C ~ +85°C (30min) (30min) (从低温到高温或从高温到低温时间必须≤2分钟), 8个循环		n=10, c=0	
8	可焊性	温度: 245°C ± 5°C, 5秒		吃锡面积≥95%焊锡面积, 同时满足光电特性中的No. 2~9项	n=10, c=0
9	耐高温试验	温度: 265°C ± 5°C , 10秒			n=10, c=0